

進行高頻量測前，必須對系統進行校正（Calibration），以去除量測儀器及環境所造成之效應，將量測系統的參考平面（Reference Plane）移至距離待測物越近越好。藉由校正基板（Impedance Standard Substrate）的量測，及網路分析儀的運算，將量測系統的參考平面移至高頻微波探針的針尖處，以去除系統、電纜及微波探針等不必要的寄生效應，最常見的校正法為 SOLT（Short、Open、Load、Through）校正法，當操作頻率低於 5GHz 時，可以只用 Open 來進行去嵌化的動作，但是當操作頻率大於 5GHz 以上時，就必須再使用 Short。Open 的 Dummy 測試元件可以扣除與元件串聯的寄生元件，而 Short 是扣除與元件並聯的寄生元件，而 Through 是用來驗證去嵌化的結果，若是扣除的結果良好，在 Through 的量測上將會顯現出完美的傳輸線（Transmission Line）金氧半場效電晶體。

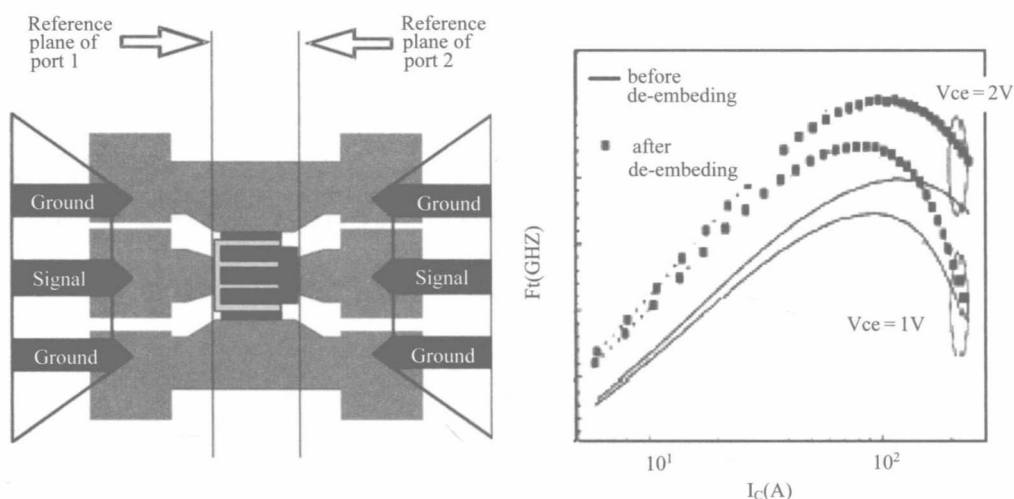


圖 13-50 RF 參數量測校正基板及有無去嵌化對截止頻率的影響。